

株式会社 ニチワ工業

当社の
会社概要
or
得意技

半導体加工装置を使用した高精度研削、切削加工 レーザー切断による高精度のガラス加工

概要

1. シリコンウェハをはじめ、金属、セラミック、ガラエポ、ガラス等の難切削材料の切断、研削等の受託が可能です。特に、加工精度においては、 $\pm 3\mu\text{m}$ と高精度の加工が可能です。また、低コスト、短納期に対応いたします。

加工後の製品は、トレイ詰めや、真空梱包等、柔軟に対応いたします。

2. センサーガラス、カバーガラス等のレーザー切断による加工を行っています。

最大G6サイズ(1,850×1,500mm)の高CT化学強化ガラスを任意のサイズ形状へ高精度に切り出しする事が可能であり、年々薄化となるカバーガラス、センサーガラスにも対応する事が出来ます。

また、個片への切り出し以外にも、面取りや穴あけ加工に加え、ガラス端面の研磨を行う事によってマイクロクラックを除去し、高い曲げ強度を実現する事が出来ます。

バックグラインド

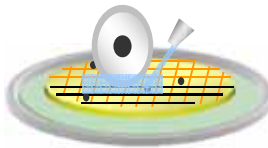


製品を砥石によって研削します。また、ポリッシュ装置も保有していますので、鏡面仕上げが可能です。(おもにシリコン)

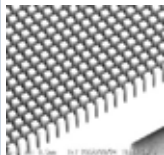


鏡面仕上げ

ダイシング



製品をダイヤモンドブレードによって切り分けます。溝入れ加工も可能です。



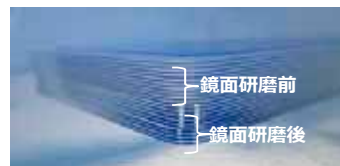
シリコン基板の溝入れ加工(30 μm 幅)

レーザー切断による異形状の加工
フェムト秒レーザー切断にて、様々な任意形状に対し、高精度に加工を行います。



端面研磨による鏡面仕上げの研磨

レーザー切断後の端面を鏡面仕上げとする事でチップング(マイクロクラック)を除去し、高い曲げ強度を達成する事が出来る。



企業概況

会社名	株式会社 ニチワ工業	代表者名	寺澤 茂
		窓口担当	佐藤 努・青木 丈
事業内容	半導体、難切削材の研削、切削加工	URL	http://www.nichiwak.co.jp
主要製品	精密研削・切削加工、情報画像サプライ品の製造		
住所	〒391-0003 長野県茅野市本町東3-17		
電話/FAX	0266-72-6840/0266-72-2498	E-mail	info2@nichiwak.co.jp
資本金(百万円)	15	設立年月日	1970/3/1
		売上(百万円)	—
		従業員数	120

特記事項 ①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

①・ISO9001:2000年取得済み

・ISO14001:2003年取得済み

②半導体加工装置を使用するため、高精度かつ大量生産が可能

③強化ガラスのフェルト秒レーザーによる切断加工が可能